

放熱絶縁接着シート 『EA 低弾性シリーズ』

使用例

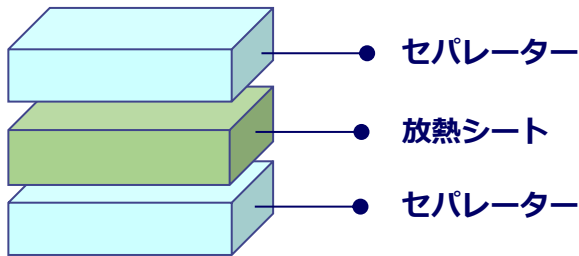
- ・パワーモジュール
- ・LED用基板
- ・インフラ、太陽光発電用基板材料



特徴

- ・放熱性、絶縁性、接着性を有する未硬化の接着シートです。
- ・いずれも低弾性で取り扱いのしやすい製品となります。
- ・EADは低誘電タイプとなります。

構成



ご要望により構成変更は可能です。

■ 製品写真



※取り扱い性がよくしなやかさがあります。

特性

製品名	EAL	EAD	EAQ
特徴	-	薄膜	高放熱
熱伝導率(LF)	W/m・K	1	10
弾性率(25°C DMA)	MPa	<100	<1000
比誘電率	-	6.0	4.6
誘電正接	-	0.020	0.040
耐電圧	hr	>1000	>1000
冷熱衝撃	cycle	>1000	>1000

※加工時の推奨条件 プレス条件：180°C×Hold60min×3~20MPa

※耐電圧 150°C×DC1kV

※冷熱衝撃 -40°C⇔150°C